



CMP 技術の基礎を理解するサマーキャンプ 2022

(公社)精密工学会 プラナリゼーション CMP 委員会

日時

2022年8月26日(金)8:30-17:45

2022年8月27日(土)8:30-15:45

方式

Zoom を使った LIVE 配信セミナー

対象者・募集人数

対象者：CMP に携わる研究者、技術者からマーケティング、営業にいたるビジネスパーソン
及び CMP 技術全般の動向を理解されたい方

募集人数：80 名

概要

本セミナーは、半導体デバイス製造技術の基礎として、CMOS プロセスと後工程技術に関しても幅広く説明します。次に、半導体製造前工程における CMP 技術を CMP の原理、プロセス、装置、材料、洗浄・クリーン化技術そして、産業動向の 6 つの観点で、基礎から応用まで網羅した分かりやすい説明をします。CMP 技術を理解する入門講座としておすすめのセミナーです。

講師

ワイドヴィル（元東京エレクトロン株式会社） 廣田 良浩

九州大学大学院教授 黒河 周平

昭和電工マテリアルズ株式会社 近藤 誠一

株式会社 荏原製作所 和田 雄高

株式会社 ISTL 磯部 晶

ニッタ・デュポン株式会社 吉田 光一

株式会社 フジミンコーポレーテッド 森永 均

グローバルネット株式会社 武野 泰彦

効果・到達目標

座学のみならず、グループ討議を通じた講師・受講者双方向の能動的な学習を行うことにより、半導体デバイス製造技術および CMP 技術と産業動向全般の理解を深める。

スケジュール

8月26日(金)1日目

オープニング: 8:30-8:45

講義 1 CMOS プロセス技術の基礎: 8:45-11:45

昼食休憩 11:45-12:30

講義 2 CMP の原理: 12:30-14:00

講義 3 CMP プロセス: 14:15-15:45

講義 4 CMP 装置: 16:00-17:15

クロージング: 17:30-17:45

8月27日(土)2日目

オープニング: 8:30-8:35

講義 5 半導体後工程プロセス: 8:35-9:50

講義 6 CMP 材料: 10:05-11:20

昼食休憩: 11:30-12:30

講義 7 CMP と洗浄・クリーン化: 12:30-13:45

講義 8 半導体ビジネスと CMP 産業: 14:00-15:15

クロージング: 15:30-15:45

受講料

15,000 円(一般参加)

10,000 円(学生)

- a. お申し込み者数が定員に達している場合には、お申し込みいただけない場合があります。
- b. やむを得ずキャンセルの場合は、原則開催日の前営業日の午後 3 時までにご連絡をください。
- c. 開催日当日のキャンセルの場合は、受講料を全額ご請求いたします。
- d. 代理参加は受付いたします。
- e. 参加特典として図解 半導体用語集 2022 年版(サクセスインターナショナル株式会社 制作・監修、グローバルネット株式会社発行)を進呈いたします。

受講について

・配布資料

開催前日までに PDF にてお送りいたします。

無断転載、二次利用や講義の録音、録画などの行為を固く禁じます。

・Zoom を使った WEB 配信セミナー受講の手順

Zoom を使用されたことがない方は、[こちら](#)からミーティング用 Zoom クライアントをダウンロードしてください。ダウンロードできない方はブラウザ版でも受講可能です。セミナー前日までに必ず動作確認をお願いします。

開催日直前に WEB セミナーへの招待メールをお送りいたします。当日のセミナー開始 10 分前までに招待メールに記載されている視聴用 URL より WEB 配信セミナーにご参加ください。

お申込み

ホームページからのオンライン参加登録をご利用ください。

連絡先

「プラナリゼーション CMP 委員会」事務局(三上)

TEL; 03-5117-2225/FAX; 03-5117-2223

Email:mikami@global-net.co.jp